

2006. 12. 13.(수) 배포

문의 / 산업기술팀장 송정수 (750-2330)

중소기업지원팀장 손승현(750-2350)

김재준 사무관 (750-2334) jjkim@mic.go.kr

김형선 사무관 (750-2354) hskim9@mic.go.kr

IT 부품 업계 대형화 유도

- IT부품업계 · 펀드업계와 공동으로 발전방안 모색 -

노준형 정보통신부장관은 13일 IT부품업계 및 펀드업계 대표와 관계자를 초청한 가운데 정보통신부 14층 중회의실에서 IT부품업계 대형화 방안을 논의하는 CEO 간담회를 개최한다.

이번 간담회는 기술력은 우수하나 규모가 영세한 IT부품업계와 M&A 시장의 중심이 되고 있는 PEF(Private Equity Fund, 사모투자펀드) 등 펀드업계 간에 산업전망 및 투자가치 의견을 공유함으로써 향후 IT부품산업의 대형화를 위한 발전방안을 논의하고 업계 간 협력을 활성화하기 위해 마련된 것이다.

이날 간담회에서는 IT부품업계의 M&A를 활성화하기 위해서 정부의 IT중소기업 전용 M&A펀드의 조성 필요성과 함께 기존 투자 조합에 대한 규약개정 등을 통해 M&A 목적 투자를 확대하는 방안이 논의되었다.

또한, 주요 핵심부품인 IT-SoC(비메모리반도체)의 개발비용에 대한 투자리스크를 줄이기 위해서 적기 제품개발에 필요한 IP(반도체설계모듈)의 공급을 원활하게 하는 'IP상용화프로그램' 신설을 검토하기로 하였다.

이 외에도 기업가치평가, 시스템·부품·펀드업계 협력네트워크, 공동연구개발을 위한 컨소시엄 구성 등 IT부품업계 대형화를 실현하기 위한 다양한 방안들을 개진하였다.

IT부품산업은 IT산업의 지속적인 성장을 가능하게 하는 성장동력의 원천이자 고부가가치의 선진국형 산업구조로 가기 위해 견인차 역할을 할 전략산업이다. 전략산업으로서의 중요성과 함께 급변하는 시장과 기술의 융복합화 추세에 따라 해외 IT부품 대기업들은 M&A나 전략적 제휴를 통해 글로벌 시장지배력을 강화해 나가고 있는 반면, 국내업체들 간의 협력사례는 많지 않은 현실속에서 정부가 IT 부품산업의 경쟁력 강화를 위해 실효성있는 노력으로 이번 간담회가 평가되고 있다.

최근 산업적 태동기에서 벗어나 성장기에 돌입하고 있는 IT부품 업계는 갈수록 가중되는 높은 제품개발비용과 시장예측의 불확실성으로 인해 업체 간의 협력 필요성을 공감하는 분위기고, 펀드 업계에서는 이러한 IT부품업계의 투자리스크가 기업가치평가 절하로 이어져 업체들의 M&A가 활성화되지 못하는 문제가 있다고 지적해 오던 차에 IT 부품업계와 펀드업계가 자리를 함께한 것도 의미가 크다.

간담회에 참석한 황기수 IT-SoC협회장은 “IT-SoC를 비롯한 IT 부품산업이 태동기를 지나 글로벌경쟁력을 확보해야 하는 시점에서 IT부품업계 대형화를 위한 장관간담회는 시의적절하고 유익했다.”고 밝히고 향후 IT부품·소재 산업의 대형화를 위한 정부의 체계적인 지원을 기대한다고 밝혔다.

- 붙임 : 1. IT부품업계 대형화를 위한 CEO간담회 개최계획(안) 1부
2. 간담회 주요 논의내용 1부
3. IT-SoC기업 현황분석 1부. 끝.

[붙임1]

IT부품업계 대형화를 위한 CEO간담회 개최계획(안)

□ 행사 목적

- IT부품업계 대형화를 위한 발전방안 논의 및 업계 간 협력 활성화

□ 행사 개요

- 일시 및 장소 : '06.12.13(수) 16:00~18:00, 정보통신부(14층 중회의실)

- 참석자안(17명)

- 정부 및 유관기관(6명): 장관, 정보통신정책본부장, 산업기술팀장, IT부품 전문위원, ETRI IT융합·부품연구소장, IITA 기술사업화지원센터장
- IT부품업계 및 펀드업계 대표(11명)

	기업명	성명	직위	비고
1	(주)코아로직	황기수	대표	IT-SoC협회장, 멀티미디어SoC
2	엠텍비전(주)	이성민	대표	카메라 컨트롤러 프로세서
3	(주)씨앤에스테크놀로지	서승모	대표	영상/음성칩, DMB 멀티미디어칩
4	슬림텍(주)	김태근	대표	ASIC 디자인 서비스
5	(주)펜타마이크로	정세진	대표	DVR용 반도체
6	피앤피네트웍(주)	김용훈	대표	DMB 모뎀칩
7	(주)아이디에스	김성민	대표	LCD 모듈
8	(주)오픈솔루션	김종욱	대표	무선 모뎀칩/음성모듈
9	KTB네트웍(주)	김한섭	대표	벤처투자, 기업구조조정투자, PEF
10	스틱아이티투자(주)	도용환	대표	벤처투자
11	코너스톤에쿼티파트너스	김석헌	대표	PEF(사모투자펀드)

□ 세부일정(안)

시간	내용	비고
16:00 ~ 16:05	참석자소개	산업기술팀장
16:05 ~ 16:10	인사 말씀	장관
16:10 ~ 16:25	IT-SoC업계 산업현황 및 발전 전망	IT-SoC협회장
16:25 ~ 16:40	IT부품업계에 대한 펀드업계 투자분석	펀드업계
16:40 ~ 17:50	IT부품업계 대형화 방안 논의	참석자
17:50 ~ 18:00	맺음 말씀	장관

[붙임2]

간담회 주요 논의내용

- ① M&A 성공사례 발굴 등을 통해 민간투자를 활성화할 목적으로 IT중소기업 전용 M&A펀드 조성 검토
 - IT전문투자조합, KIF투자조합 등 기존 운용자금에 대한 규약 개정 등을 통해 M&A 목적 투자허용 확대방안 검토
 - ※ IT전문투자조합은 이미 M&A 투자목적 허용위한 표준규약 개정('06.5) 단행
- ② 전문협의회와 협회 등을 통하여 M&A 전문교육 및 컨설팅을 실시하여 M&A에 대한 부정적인 인식완화 및 효과홍보
 - 시스템/부품/펀드 업계 간 협력활성화를 위해 공동협력분야 발굴을 위한 컨설팅, 업계 간 협력네트워크 등 검토 추진
- ③ IT부품업계의 투자가치 향상을 위해 개발비용 급증문제와 투자리스크 완화를 위한 정부지원정책 강화
 - 기존, 업계수요가 높은 고가의 해외 IP를 도입하여 공동활용을 지원하고 있으나 지속적인 확대에는 예산상 한계가 있음
 - 국책연구과제에서 개발된 IP 중 산업체 수요가 높은 IP를 발굴하여 상용화하는 'IP상용화프로그램' 신설 추진
- ④ 기업가치평가의 역량제고를 위해 VC 등 투자심사역 종사자들을 대상 정기적인 교육 및 세미나 등에 부품업계 정보교류 강화
 - ※ 투자심사역 교육('06.6~8) : 국내교육(강의 14회, 현장방문 등), 국외교육(홍콩심천, 산호세)

[붙임3]

IT-SoC기업 현황분석

□ IT-SoC 시장 현황

- 세계 IT-SoC 시장은 '10년 세계시장이 2,251억불 규모, 연평균성장률 8.3%로 성장하여 반도체 전체 성장을 견인할 것으로 예상

< 세계 반도체 시장 현황 및 전망 >

(단위 : 억불, %)

구 분	2005	2006	2007	2008	2009	2010	CAGR
반도체 전체	2,348	2,591	2,831	3,158	3,128	3,409	7.8
메모리	498	604	663	735	587	631	4.9
SoC(시스템LSI)	1,506	1,600	1,747	1,956	2,047	2,251	8.3
단품,광,센서 등	344	387	421	467	494	527	8.9
SoC 비중(%)	64.1	61.8	61.7	61.9	65.4	66.0	-

※ 자료 : Gartner Dataquest(2006. 11.)

- 기존 휴대전화, 컴퓨터에 집중되었던 시장이 DTV와 DMB, 텔레매틱스, RFID, 홈네트워킹 등 다양한 응용분야로 확대 중
- SoC업계는 설계/생산을 모두 담당하는 종합반도체회사(IDM), 수탁생산 전문회사인 파운드리와 설계 전문회사인 팹리스(IT-SoC기업)로 분류

※ 국내 IDM은 삼성전자, 매그나칩반도체, 파운드리회사는 동부아남반도체 임

- IDM/파운드리 기업매출(3.35조원)이 전체의 74%를 차지하는 반면 팹리스 업체는 대부분 300인 미만의 중소기업으로 규모가 영세함

< 국내 반도체업계 매출액 >

(단위: 조원)

	2003년		2004년		2005년	
	반도체전체	비메모리	반도체전체	비메모리	반도체전체	비메모리
삼성전자	12.71	1.82	18.22	2.28	16.08	2.01
하이닉스	3.6	0.9	5.86	1.2	5.75	-
매그나칩	-	-	-	-	0.985	0.985
동부아남	0.265	0.265	0.4	0.4	0.356	0.356
Fabless	0.65	0.65	1.0	1.0	1.2	1.2
합계	17.225	3.655	25.48	4.88	24.371	4.551

※ 자료 : IT-SoC협회(2006)

□ 국내 IT-SoC기업 현황

- SoC설계의 복잡도는 증가하는 반면 시장에서 요구하는 개발기간은 짧아지고 있어서, 적기 시장진입이 성공여부에 중요 요소로 부각
 - 적기 시장진입을 위해 IP 재사용 및 표준화, SoC 검증방법론 등에 대한 필요성이 커지고 있으나, 아직 체계적인 준비가 미흡한 상태
- 나노공정기술 발전으로 시스템을 하나의 칩으로 통합시키는 SoC화는 더욱 탄력을 받을 것으로 예상되나 이에 따른 개발비용은 급격히 증가
 - 90nm 공정의 경우 NRE가 7억원에 이르며 고집적도의 SoC제작을 위해 필요한 65nm 공정의 경우 제품개발에 30억원 이상이 소요될 것으로 예상

<공정기술 별 소요비용>

(단위 : 천원)

공정기술	0.5 μ m	0.35 μ m	0.25 μ m	0.18 μ m	0.13 μ m	90nm
최고값	40,000 (1.05)	80,000 (2.11)	148,000 (3.89)	290,000 (7.63)	508,500 (13.38)	700,000 (18.00)
중간값	39,000 (1.03)	68,100 (1.79)	132,500 (3.49)	205,000 (5.39)	421,750 (11.10)	700,000 (18.00)
최저값	38,000 (1.00)	56,200 (1.48)	117,000 (3.08)	120,000 (3.16)	335,000 (8.82)	700,000 (18.00)

※ 자료 : ETRI SoC산업진흥센터(2006)

- 업체 대부분이 1~2종류의 제품을 생산하고 있으며 납품업체 또한 특정 업체에 집중되는 Single Product/Single Customer의 문제 내포

<국내 10대 Fabless기업의 제품과 주 납품업체>

(단위 : 십억원)

순위	기업명	매출액('05년)	주력제품	주 납품업체
1	엠텍비전	178	휴대 폰 멀티미디어칩	삼성전자 외 휴대폰업체
2	코아로직	162	휴대 폰 멀티미디어칩	LG전자 외 휴대폰업체
3	이엠엘에스아이	82	SRAM	Nokia
4	텔레칩스	65	MP3칩, DMB용 멀티미디어칩	삼성전자, LG전자
5	픽셀플러스	45	CMOS이미지센서	삼성전기, Ningbo Bird
6	다원텍	45	타이밍 컨트롤러	LG필립스LCD, 삼성SDI
7	토마토엘에스아이	40	LCD 구동 칩	삼성전자, WINTEX
8	씨앤에스테크놀로지	30	DMB용 칩	삼성전자, 엠텍비전
9	티엘아이	29	타이밍 컨트롤러	LG필립스LCD
10	상화마이크로텍	20	디자인서비스	Fabless업체

※ 자료 : IT-SoC협회(2006)

□ 국내 IT-SoC기업(Fabless)의 SWOT 분석

<p style="text-align: center;">강점(Strength)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특정 IT SoC 전문분야 선택과 집중 (휴대폰-멀티미디어, 홈네트워크-모뎀 등) ○ 경험 있는 고급 개발인력 중심 (50%이상 석박사 인력, 46%이상의 5년 이상 개발 경력) ○ IT839 등 정부의 신성장산업 추진동력 	<p style="text-align: center;">약점(Weak)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 영세한 기업 규모 ('03년 세계시장 매출비중 2%, 10대 기업 평균 매출 1/50, 인력 1/35) ○ 국내 SoC기업의 낮은 생산성(5.99억원/인) ○ Single Product/Single Customer ○ 국내 SoC기업에 대한 낮은 신뢰성
<p style="text-align: center;">기회(Opportunity)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 국내 SoC 기업의 고속 성장 추세 (2004년 202% 매출증가, 261% 수출성장) ○ 국내 시스템 기업(LG, 삼성 등)의 우수한 글로벌 경쟁력 ○ SoC 선두기업 저변 확대 (400억이상 기업: 4개('03년)->10('06년)) 	<p style="text-align: center;">위협(Threat)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 외국 제품의 국내시장 선점경쟁 강화 ○ 시스템통합화와 개발비용(NRE) 급증 ○ 선진국 및 경쟁국의 종합적이고 공격적인 SoC 육성 정책 (대만의 SiSoft, 중국의 ZCI 계획)



"현재의 성장한계를 극복, 글로벌 기업군으로 도약하기 위해서는 M&A 등을 통한 규모의 경제를 기반으로 제품 다변화와 해외시장 진출 확대 필요"

□ 국내 · 외 주요 M&A 사례

- 미국 등 해외 선두기업 간의 M&A가 활발히 진행되어 업체의 대형화 및 전문화가 진행되고 있는 반면, 국내 업체간 사례는 거의 없는 상태
- 올해 상반기에 국내 인티그런트테크놀로지즈가 미국의 ADI에 인수된 사례가 있으며 이번달 들어서 동부일렉트로닉스가 토마토LSI를 인수함

<최근 국내 · 외 주요 M&A 사례>

	인수 주체	인수 대상	비 고
2006	Qualcomm	RFMD	블루투스 사업 부문
	AMD	ATI	그래픽 프로세서
	LSI Logic	Agere Systems	Storage SoC
	NetLogic	Cypress	NSE제품군 생산라인
	Everlight Electronics	Fairchild Semiconductor	LED Display제품군
	PCM-Sierra	Avago Technologies	storage 반도체 부문
	PMC-Sierra	Passave	FTTH SoC
	Marvel	Avago Technologies	프린터 ASIC사업
	ADI	인티그런트테크놀로지즈	DMB RFIC
	동부일렉트로닉스	토마토LSI	LCD 구동칩